



株式会社 UKCホールディングス

## 2019年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）



2019年2月7日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社UKCホールディングス  
 コード番号 3156 URL https://www.ukcgroup.com/  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 栗田 伸樹  
 問合せ先責任者 (役職名) 常務執行役員 IR部部長 (氏名) 大澤 剛 TEL 03-3491-6575  
 四半期報告書提出予定日 2019年2月13日 配当支払開始予定日 -  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有  
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

## 1. 2019年3月期第3四半期の連結業績 (2018年4月1日~2018年12月31日)

## (1) 連結経営成績 (累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2019年3月期第3四半期	158,570	△32.9	3,779	△2.1	3,684	2.7	2,776	16.7
2018年3月期第3四半期	236,164	18.1	3,860	-	3,589	-	2,378	-

(注) 包括利益 2019年3月期第3四半期 1,235百万円 (△73.8%) 2018年3月期第3四半期 4,725百万円 (-%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2019年3月期第3四半期	176.90	-
2018年3月期第3四半期	151.53	-

## (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2019年3月期第3四半期	99,592	39,521	39.3	2,493.80
2018年3月期	116,144	39,768	33.9	2,506.08

(参考) 自己資本 2019年3月期第3四半期 39,143百万円 2018年3月期 39,337百万円

## 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2018年3月期	-	30.00	-	30.00	60.00
2019年3月期	-	62.50	-	-	-
2019年3月期 (予想)	-	-	-	37.50	100.00

(注) 1 直前に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無  
 2 第2四半期末の配当の内訳 普通配当 37円50銭 特別配当 25円00銭

## 3. 2019年3月期の連結業績予想 (2018年4月1日~2019年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	220,000	△27.0	4,500	2.6	4,000	2.3	2,800	31.5	178.38

(注) 直前に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

なお、特定子会社の異動には該当していませんが、2018年5月1日付で株式会社LSIテクノの株式を取得し連結子会社としたため、第1四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。また、同日付で株式会社LSIテクノは株式会社UKCシステムエンジニアリングに商号変更しております。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2019年3月期3Q	15,700,021株	2018年3月期	15,700,021株
② 期末自己株式数	2019年3月期3Q	3,794株	2018年3月期	3,367株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2019年3月期3Q	15,696,385株	2018年3月期3Q	15,696,736株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び注意事項等については、添付資料P. 3「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

（四半期決算説明資料の入手方法について）

四半期決算説明資料はT D n e tにて同日開示するとともに、当社ウェブサイトに掲載いたします。

（日付の表示方法の変更）

「2019年3月期 第1四半期決算短信」より日付の表示方法を和暦表示から西暦表示に変更しております。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)	8
(セグメント情報等)	8
(追加情報)	9
(重要な後発事象)	11

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府及び日銀の経済・金融政策を背景とした企業収益、雇用情勢や設備投資の改善等、緩やかな回復基調にあるものの、海外に目を向けると、米中間の通商問題、英国のEU離脱問題や地政学的リスク等、依然として先行き不透明な状況が続いております。

当社グループが属しておりますエレクトロニクス業界におきましては、自動車の電子化・自動化やI o T（モノのインターネット化）／A I（人工知能）の進展により、車載、産業分野を中心に市場の拡大が期待されます。

このような状況の下、当社グループは、ソニー製の半導体・電子部品事業を軸とし、自社工場におけるEMS（電子機器受託製造サービス）等の高付加価値事業を展開する一方で、資本生産性や利益率の向上を指標とした既存事業の再強化に努めてまいりました。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は1,585億70百万円（前年同期比32.9%減）、営業利益は37億79百万円（前年同期比2.1%減）、経常利益は36億84百万円（前年同期比2.7%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は27億76百万円（前年同期比16.7%増）となりました。当社の主力事業である半導体及び電子部品事業を中心とした事業ポートフォリオの再構築により、売上総利益率は前年同期の5.3%から7.4%に、また営業利益率も前年同期の1.6%から2.4%に上昇しました。

セグメント別の業績は次の通りです。

#### ・半導体及び電子部品事業

半導体及び電子部品事業におきましては、サムスングループへのソニー半導体・電子部品の販売終了等により減収となったものの、売上総利益率の向上と、香港及びシンガポールの貸倒引当金の回収（戻入）により、セグメント利益率は改善しました。

以上の結果、売上高は1,459億12百万円（前年同期比34.8%減）、セグメント利益は38億48百万円（前年同期比1.6%減）となりました。

#### ・電子機器事業

電子機器事業におきましては、業務用放送機器及び半導体装置向けF Aカメラの販売が堅調に推移した一方で、ソリューションビジネス等の新規ビジネス拡大に伴い販売費及び一般管理費が増加しました。

以上の結果、売上高は118億83百万円（前年同期比0.3%増）、セグメント損失は32百万円（前年同期は21百万円の損失）となりました。

#### ・システム機器事業

非接触I Cカード関連事業におきましては、電子マネー用決済端末の需要が拡大し、半導体及び電子部品の信頼性試験・環境物質分析サービス事業におきましては、車載、太陽光関連の受注が増加しました。

以上の結果、売上高は20億57百万円（前年同期比11.1%増）、セグメント利益は98百万円（前年同期比2.2%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を行っております。

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して165億51百万円減少し、995億92百万円となりました。これは主に、現金及び預金の減少51億68百万円、受取手形及び売掛金の減少102億83百万円、電子記録債権の増加10億70百万円、たな卸資産の減少19億69百万円、その他流動資産の減少13億80百万円、投資有価証券の減少4億87百万円及び固定化営業債権の減少6億8百万円によるものであります。

負債は、前連結会計年度末と比較して163億4百万円減少し、600億70百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少68億78百万円、短期借入金の減少54億24百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少20億円、未払法人税等の減少1億66百万円及びその他流動負債の減少13億28百万円によるものであります。

純資産は前連結会計年度末と比較して2億46百万円減少し、395億21百万円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益27億76百万円、利益剰余金からの配当14億51百万円、為替換算調整勘定の減少9億10百万円を主因としたその他の包括利益累計額の減少額15億17百万円によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第3四半期累計連結業績は好調に推移しておりますが、仕入先の一社である中華映管股份有限公司が2018年12月14日に台湾桃園地方法院に対し会社更生手続の申立てを行い、当社業績に影響を及ぼす可能性があること、また2019年4月1日に予定している株式会社バイテックホールディングスとの経営統合に係るコスト(オフィス統合に係るコスト等)の発生が見込まれることから、通期の業績予想につきましては、現段階では2018年5月11日に公表しました予想値を据え置きます。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2018年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	18,162	12,993
受取手形及び売掛金	58,299	48,016
電子記録債権	3,866	4,937
商品及び製品	21,033	17,348
仕掛品	837	2,165
原材料及び貯蔵品	589	976
前渡金	246	978
その他	5,016	3,636
貸倒引当金	△626	△694
流動資産合計	107,426	90,357
固定資産		
有形固定資産	3,100	3,399
無形固定資産	263	420
投資その他の資産		
投資有価証券	4,191	3,703
固定化営業債権	10,440	9,832
その他	2,357	2,408
貸倒引当金	△11,635	△10,528
投資その他の資産合計	5,353	5,414
固定資産合計	8,717	9,234
資産合計	116,144	99,592
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	32,554	25,675
短期借入金	35,518	30,094
1年内返済予定の長期借入金	2,300	300
未払法人税等	480	314
賞与引当金	424	293
その他	4,060	2,731
流動負債合計	75,338	59,408
固定負債		
役員退職慰労引当金	43	45
退職給付に係る負債	197	158
その他	795	457
固定負債合計	1,036	661
負債合計	76,375	60,070

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2018年12月31日)
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	4,383	4,383
資本剰余金	5,871	5,871
利益剰余金	24,668	25,993
自己株式	△5	△6
株主資本合計	34,918	36,241
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,366	753
為替換算調整勘定	3,069	2,159
退職給付に係る調整累計額	△16	△11
その他の包括利益累計額合計	4,419	2,901
非支配株主持分	431	378
純資産合計	39,768	39,521
負債純資産合計	116,144	99,592

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
 (四半期連結損益計算書)  
 (第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
売上高	236,164	158,570
売上原価	223,642	146,901
売上総利益	12,521	11,669
販売費及び一般管理費	8,660	7,889
営業利益	3,860	3,779
営業外収益		
受取利息	20	36
受取配当金	32	170
為替差益	—	328
受取補償金	200	—
その他	54	72
営業外収益合計	308	608
営業外費用		
支払利息	518	643
為替差損	16	—
その他	44	60
営業外費用合計	579	704
経常利益	3,589	3,684
特別利益		
投資有価証券売却益	330	—
特別利益合計	330	—
特別損失		
減損損失	66	—
固定資産除却損	64	—
事業整理損	—	261
過年度決算訂正関連費用	362	—
特別損失合計	493	261
税金等調整前四半期純利益	3,426	3,422
法人税等	1,075	669
四半期純利益	2,350	2,753
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△27	△23
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,378	2,776



(四半期連結包括利益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
四半期純利益	2,350	2,753
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2,461	△612
為替換算調整勘定	△84	△910
退職給付に係る調整額	△2	4
その他の包括利益合計	2,374	△1,517
四半期包括利益	4,725	1,235
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	4,753	1,259
非支配株主に係る四半期包括利益	△27	△23

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)

該当事項はありません。

なお、特定子会社の異動には該当していませんが、2018年5月1日付で株式会社L S Iテクノの株式を取得し連結子会社としたため、第1四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。また、同日付で株式会社L S Iテクノは株式会社U K Cシステムエンジニアリングに商号変更しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自2017年4月1日至2017年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額 (注1)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注2)
	半導体及び 電子部品	電子機器	システム機 器	計		
売上高						
外部顧客への売上高	223,871	10,522	1,769	236,164	—	236,164
セグメント間の内部売 上高又は振替高	45	1,327	82	1,455	△1,455	—
計	223,917	11,850	1,851	237,619	△1,455	236,164
セグメント利益又は損失 (△)	3,910	△21	101	3,989	△129	3,860

(注) 1. セグメント利益又は損失の調整額△129百万円には、セグメント間消去取引1百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△130百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

半導体及び電子部品セグメントにおいて、固定資産減損損失66百万円を計上しております。

II 当第3四半期連結累計期間(自2018年4月1日至2018年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額 (注1)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注2)
	半導体及び 電子部品	電子機器	システム機 器	計		
売上高						
外部顧客への売上高	145,864	10,807	1,898	158,570	—	158,570
セグメント間の内部売 上高又は振替高	48	1,076	158	1,283	△1,283	—
計	145,912	11,883	2,057	159,854	△1,283	158,570
セグメント利益又は損失 (△)	3,848	△32	98	3,914	△134	3,779

(注) 1. セグメント利益又は損失の調整額△134百万円には、セグメント間消去取引1百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△136百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

## 2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

第1四半期連結会計期間より、株式会社L S Iテクノ(株式会社L S Iテクノは株式会社U K Cシステムエンジニアリングに商号変更)の株式を取得したため新たに連結の範囲に含めております。これにより同社の主力事業である「半導体及び電子部品」セグメントにおいてのれんが増加しております。当該事象によるのれんの増加額は、当第3四半期連結累計期間において、159百万円であります。

なお、第2四半期連結累計期間において、のれんは取得原価の配分等が完了していないため、暫定的に算定された金額でありましたが、当第3四半期連結会計期間に確定しております。なお、のれんは金額に修正は生じておりません。

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

(経営統合に関する基本合意書の締結)

当社は、2018年9月14日開催の取締役会において、株式会社パイテックホールディングス(以下「パイテック」といい、当社と合わせて「両社」といいます。)との間で、対等の精神に則った経営統合(以下「本経営統合」といいます。)を行うことを決定し、「経営統合契約書」の締結をいたしました。なお、本経営統合は、2018年11月27日開催の両社の臨時株主総会において承認されました。また、本経営統合は国内外の関係当局の許可等を得ることを前提としております。

## 1. 本経営統合の目的

当社は、2009年10月の株式会社ユーエスシーと共信テクノソニック株式会社の共同株式移転による設立以降、ソニー製イメージセンサーに加え、タッチパネル並びに液晶パネル関連部材の取扱いを中心とする半導体及び電子部品事業、放送用カメラを始めとする業務用製品の取扱いを中心とする電子機器事業、NFC・Felica対応の非接触ICカード関連製品の取扱いを中心とするシステム機器事業を運営してまいりました。競争力のあるこれらの取扱い製品に、専門エンジニアリング組織によるきめ細かな技術サポート、EMS(電子機器受託製造サービス)、半導体・電子部品の信頼性試験や環境物質分析サービスを組み合わせることにより、お客様に満足いただけるソリューションを提供しております。中期的には、「利益を生み出す技術提案力の強化」による技術商社への飛躍を果たすべく、既存事業の再強化とともに、技術ベースのシステムソリューションやAI(人工知能)/IoT(モノのインターネット化)関連事業の基盤固めを行っており、高収益体質の確立と新規/成長分野への投資の本格的な開花により、企業価値の拡大を目指しております。

一方、パイテックは、1987年にソニー製半導体・電子部品を取り扱う特約店として創業し、その後、海外メーカーを中心とした製品ラインナップ(取扱い商材)・販路の拡充に取り組むとともに、積極的な業務・資本提携等を通じて業容の拡大に努め、調達事業及び新規分野として2010年には環境エネルギー事業(発電・新電力・植物工場)にも参入して売上と利益の両面において大幅に伸長しております。また、2018年2月26日に公表しております「新中期経営計画」において、『世界・社会貢献・共創』のキーワードのもと、新たな事業展開による収益の拡大を目指し、構造改革を行い、高付加価値への転換を加速させながら成長と利益の創出に努め、エレクトロニクス価値共創企業の実現を目指して多様な展開を進めております。

近年、「市場の成熟化と新興企業参入による競争激化」、「AI/IoT時代の幕開け」、「取引先様のニーズの多様化・高度化」、「資本市場からの経営効率・企業価値最大化の要請」、「業界大手メーカー等の経営再編・事業方針の変更・商流変更」といったキーワードで代表されるように、エレクトロニクス商社を取り巻く環境は大きく変化しています。そのような中で、今後の事業の継続的な成長・発展を実現するためには、業容及び領域・顧客の拡大、商材の拡充及びソリューション提案、技術開発サポート等の高付加価値ビジネス創出の取組みが不可欠となっております。

両社は、エレクトロニクス商社の業界でリーダーシップを発揮していくためには、上記の取組みを行うとともに、他社とのアライアンスにより事業の規模及び収益を一層拡大、追求していくことが必要であるとの認識の下、協議を行ってまいりました。その結果、当社が掲げる経営理念「エレクトロニクスの分野で、技術とイノベーションにより新たな価値を創造し、社会の発展に貢献します」とパイテックが掲げる「『デバイスビジネス』と『環境エネルギービジネス』で豊かな生活と地球にやさしい未来を創造する」の間には親和性があり、両社のサプライヤー及び顧客、EMS事業、調達事業、電子機器事業、エンジニアリングサービス事業、海外展開においても相当の補完性が認められることから、両社の経営資源を相互に活用できる最適なパートナーの関係にあるとの共通認識を持つに至りました。より具体的には、事業シナジーが見込まれる両社が経営統合し、売上と利益の拡大を目指すとともに、統合による単なる効率化にとどまらず、独自性を活かしつつ両社の強みを更に融合発展させることにより、顧客とサプライヤーの双方に対してより高付加価値サービスの提供を行うことが可能になるとの認識で一致

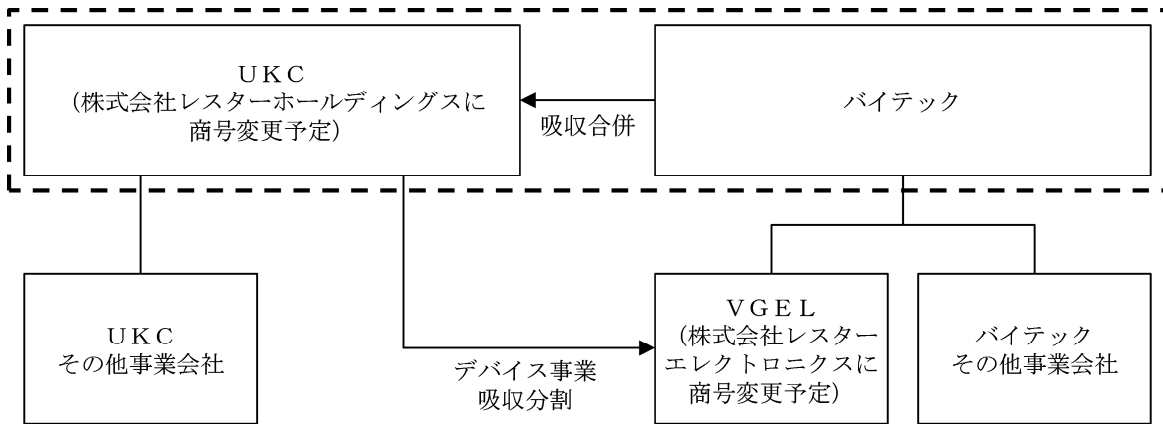
し、また、環境エネルギー事業においても両社の経営資源を活かし、シナジーを追求できると判断し、対等の精神の下、本経営統合を行うことで合意いたしました。

2. 本経営統合の方式

両社のそれぞれの株主総会による承認及び本経営統合に必要な国内外の関係当局の許認可を得ることを前提に、当社を吸収合併存続会社、バイテックを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といい、本合併後の当社を「統合持株会社」といいます。）を行います。また、本合併の効力発生及び当社の臨時株主総会における商号変更に係る定款の一部変更の承認を条件として、統合持株会社は、本合併の効力発生日（2019年4月1日予定）に、その商号を「株式会社レスターホールディングス」に変更する予定です。

その後、本合併の効力発生日において、本合併の効力発生を停止条件として、統合持株会社を吸収分割会社、バイテックの完全子会社であるバイテックグローバルエレクトロニクス株式会社（以下、「VGEL」といい、本分割後のVGELを「統合デバイス事業会社」といいます。）を吸収分割承継会社とする吸収分割（以下、「本分割」といいます。）を行うことにより、当社のデバイス事業をVGELに承継いたします。また、本分割の効力発生及びVGELの臨時株主総会における商号変更に係る定款の一部変更の承認を条件として、吸収分割承継会社であるVGELは、本分割の効力発生日（2019年4月1日予定）に、その商号を「株式会社レスターエレクトロニクス」に変更する予定です。

ただし、手続面その他の事由により必要な場合には、両社で協議・合意の上、上記の方式は今後変更される可能性があります。



3. 本経営統合の日程

取締役会決議日（当社、バイテック、VGEL）	2018年9月14日
本吸収合併契約締結日（当社、バイテック）	2018年9月14日
本吸収分割契約締結日（VGEL、当社）	
臨時株主総会基準日公告日（当社、バイテック）	2018年9月15日
臨時株主総会基準日（当社、バイテック）	2018年9月30日
臨時株主総会決議日（当社、バイテック、VGEL）	2018年11月27日
最終売買日（バイテック）	2019年3月26日（予定）
上場廃止日（バイテック）	2019年3月27日（予定）
本合併の効力発生日（当社、バイテック）	2019年4月1日（予定）
本分割の効力発生日（VGEL、当社）	

本合併及び本分割の効力発生日は同日ではありますが、本分割の効力発生は本合併の効力発生を停止条件としております。

上記日程のうち本合併に係る日程は、本合併に係る手続の進行上の必要性その他の事由に応じ、当社及びバイテックで協議の上、変更される場合があります。また、上記日程のうち本分割に係る日程は、本分割に係る手続の進行上の必要性その他の事由に応じ、当社及びVGELで協議の上、変更される場合があります。

4. 本合併に係る割当ての内容

	当社 (吸収合併存続会社)	バイテック (吸収合併消滅会社)
本合併に係る 合併比率	1	1

5. 吸収合併存続会社/吸収分割会社(当社)の概要

	吸収合併存続会社/吸収分割会社
(1) 名称	株式会社レスターホールディングス
(2) 本店所在地	東京都品川区東品川三丁目6番5号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼CEO 今野 邦廣 代表取締役社長兼COO 栗田 伸樹
(4) 取締役	代表取締役会長兼CEO 今野 邦廣 代表取締役社長兼COO 栗田 伸樹 取締役 三好 林太郎 取締役 原田 宜 取締役 矢島 浩 取締役 稲葉 俊彦 監査等委員 成瀬 達一 監査等委員 朝香 友治 監査等委員 島崎 憲明 監査等委員 松山 遙 監査等委員 戸川 清 監査等委員 手塚 仙夫
(5) 事業内容	半導体及び電子部品事業、電子機器事業、システム機器事業、調達事業、環境エネルギー事業、新電力事業、植物工場事業を営む会社の株式又は持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること(純粋持株会社)
(6) 資本金	4,383百万円
(7) 決算期	3月
(8) 純資産	未定
(9) 総資産	未定

吸収分割承継会社(現VGEL)の概要

	吸収分割承継会社
(1) 名称	株式会社レスターエレクトロニクス
(2) 所在地	東京都品川区
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 矢島 浩
(4) 事業内容	半導体および電子部品等の販売
(5) 資本金	310百万円
(6) 決算期	3月
(7) 純資産	未定
(8) 総資産	未定

(重要な後発事象)

該当事項はありません。